

2024年11月6日

半導体後工程自動化・標準化技術研究組合

**NEDO 公募「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発
(委託)」における「先端パッケージング等を含む後工程の自動化にかかる技術開発」
の採択について**

半導体製造のパッケージング・アセンブリーやテスト工程（以下、後工程）のトランスフォーメーションおよび完全自動化・標準化にかかる研究開発を行う「半導体後工程自動化・標準化技術研究組合」（以下、SATAS）は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、NEDO）の「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発（委託）」の公募に対し、「半導体後工程自動化・標準化の開発・実証に関する研究開発」を提案し、委託先として採択されましたのでお知らせいたします。

「半導体後工程自動化・標準化の開発・実証に関する研究開発」では、後工程の完全自動化に必要な各装置間の物理的・論理的な業界標準インタフェースの仕様を作成し、その仕様に従った装置の開発と実装ならびに単体試験を実施、各装置を統合したパイロットラインでの結合試験や動作検証を経て、パイロットライン全体としてのエネルギー生産性改善に資する研究開発を行います。

本研究開発を推進するには、パイロットラインの主要な構成要素である自動搬送・保管システム（AMHS：Automated Material Handling Systems）、キャリア（Carrier）、トレイ（Tray）、パネル（Panel）、ロードポート（Load Port）、フロントエンドモジュール（Equipment Front End Module）、メインフレーム（Mainframe）、組立・検査セル（Assembly & Metrology Cell）について、業界を代表する国内外の半導体メーカー、OSAT（Outsourced Semiconductor Assembly and Test）企業、装置メーカー、研究機関、標準化団体等が協力し、半導体製造の協調領域におけるトランスフォーメーションを促していく必要があります。

SATASは、半導体業界における国内外のステークホルダーとの協働を実現する技術研究組合としての役割を担い、2028年度以降の実用化を目指して研究開発に取り組むことで、先進国における後工程自動化市場の創出と日本の半導体関連産業の競争力強化に貢献します。

○経済産業省 Web サイト：

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/post5g/20241106.html

○NEDO Web サイト：

https://www.nedo.go.jp/koubo/IT3_100330.html

半導体後工程自動化標準技術研究組合の概要

設立日	2024年4月16日
理事会	理事長：鈴木 国正（インテル株式会社 代表取締役会長）
	理事：高橋 知樹（株式会社三菱総合研究所 情報通信分野担当本部長）
	理事：浜島 雅彦（有限会社セミ・ジャパン 代表取締役）
	監事：三尾 美枝子（紀尾井町法律事務所 弁護士）
組合員 *50音順	アオイ電子株式会社 Intel Corporation インテル株式会社 オムロン株式会社 化研テック株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所 シャープ株式会社 信越ポリマー株式会社 シンフォニアテクノロジー株式会社 有限会社セミ・ジャパン 株式会社ダイフク TDK 株式会社 伯東株式会社 平田機工株式会社 株式会社 FUJI 株式会社三菱総合研究所 ミナミ株式会社 ミライアル株式会社 村田機械株式会社 ヤマハ発動機株式会社 株式会社レゾナック・ホールディングス ローツェ株式会社
本部所在地	東京都千代田区永田町2丁目10番3号 株式会社三菱総合研究所内
事業内容	半導体後工程の自動化・標準化に係る研究開発を推進。半導体生産の経済性に大きな影響を及ぼすことになる後工程に着目し、省力化・自動化推進に必要な装置・システム間の標準化を進め、プロト、商用モデル、パイロットラインでの検証を行う。